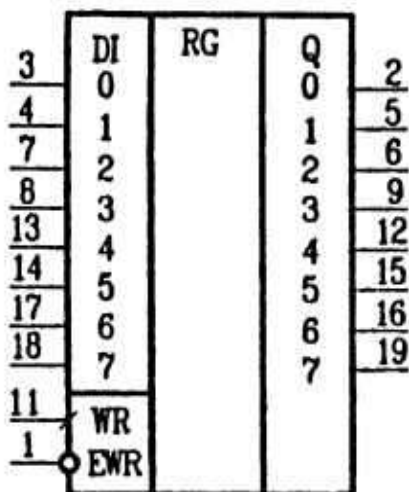


КР1533ИР27, КФ1533ИР27, ЭКР1533ИР27, ЭКФ1533ИР27

Микросхемы представляют собой 8-разрядный регистр D-типа с разрешением записи. Корпус типа 2140.20-8, масса не более 2,6 г, 4121.20-В и 2140.20-В.



Условное графическое обозначение КР1533ИР27, КФ1533ИР27,
ЭКР1533ИР27, ЭКФ1533ИР27

Назначение выводов: 1 - вход разрешения записи; 2, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 19 - выходы Q0...Q7; 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18 - информационные входы D0...D7; 10 - общий; 11 - вход строба записи WR; 20 - напряжение питания.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня	≤ 0,4 В
Выходное напряжение высокого уровня	≥ 2,4 В
Ток потребления при U _п = 5,5 В	≤ 29 мА
Входной ток низкого уровня:	
- по выводам 1, 11	≤ -0,1 мА
- по выводам 3, 4, 8, 13, 14, 17, 18	≤ -0,2 мА
Входной ток высокого уровня	≤ 20 мкА
Выходной ток	-30 ... -112 мА
Время задержки распространения сигнала при включении от вывода 11 к выводам 2, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 19	≤ 15 нс
Время задержки распространения сигнала при выключении от вывода 11 к выводам 2, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 19	≤ 11 нс

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня	2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход	5,5 В
Температура окружающей среды	-10...+70 °С

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по

ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения $5 \text{ В} \pm 10\%$, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.